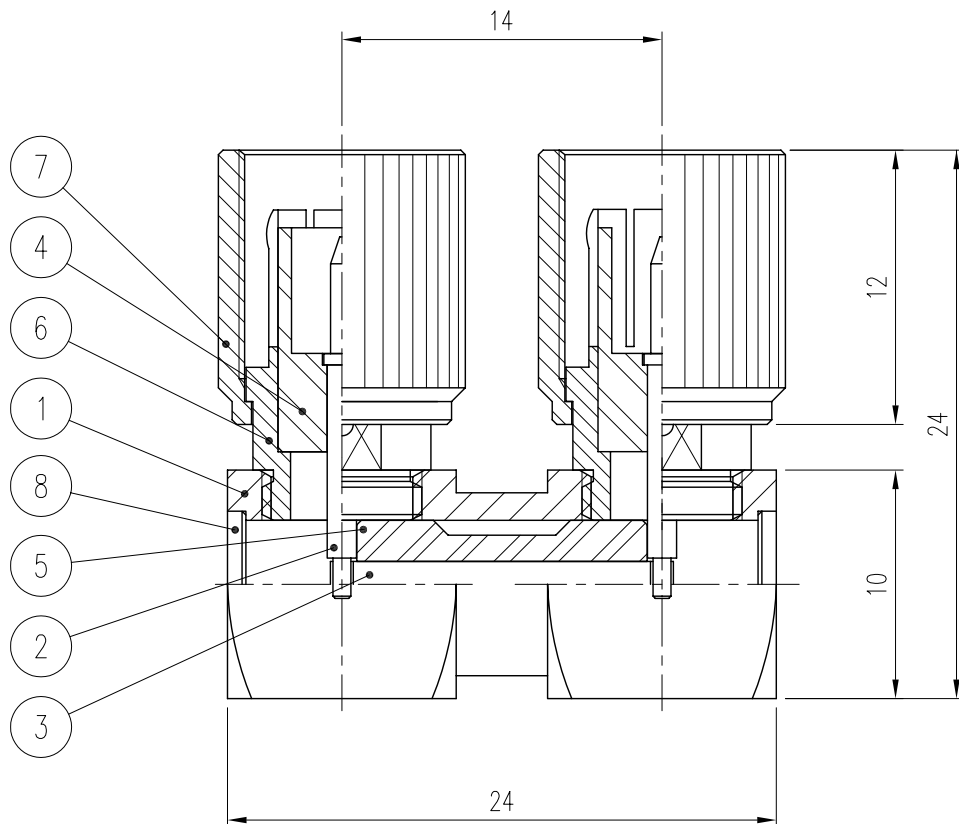


기 종 ST										수 정 내 용				
									부 호	내 용	수 청 자	승 인 자	년 월 일	
ST(기초)									△					
ST(개선)									△					



8	COVER	2	MBsBD	Nickel Plate	DCO00048-5/1 (L5005)
7	COUPLING CAP	2	MBsBD	Nickel Plate	DCU00104-5/1 (K5010)
6	JACK	2	BeCu	Gold Plate	DJA00086-5/1 (J5005)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01059-N/1 (H5039)
4	INSULATOR	2	TEFLON		DIN01058-N/1 (H5038)
3	CONTACT	1	PBR	Gold Plate	DCT01139-5/1 (E5038)
2	CONTACT	2	PBR	Gold Plate	DCT01138-5/1 (E5037)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01491-5/1 (D5044)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	1996. 10. 23.			COMTECH RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
재질	검도				도명	1.6/5.6DIN-U-LINK VER.0	
열처리	재도						
보호파막처리	작성부서	연 구 소			A4	도번	AD00135-7/1
	척도 1.5/1	단위 mm	중량				K318-790-002